上海维科精密模塑股份有限公司

关于对外投资意向合作的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资意向合作概述

上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司"或"维科精密")凭借深耕汽车零部件行业二十余年的发展经验,依托较为全面的工艺技术储备及产品生产能力,具备为新能源汽车、工业控制、光伏逆变器等高端应用场景提供高性能、高可靠性零部件的能力,成功开发出适用于功率半导体的绝缘耐高温侧框及高精度引线框架等半导体核心精密零部件产品。产品在耐高温、电气隔离、结构稳定性等方面表现优异,已通过芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"芯联集成")等多家头部功率半导体厂商的验证,并实现批量供货。为构建更加完善的产业链,增强市场竞争优势,公司与芯联私募基金管理(杭州)合伙企业(有限合伙)(以下简称"芯联基金")签署了《合资经营合同》,公司拟与芯联基金作为私募基金管理人于浙江省绍兴市所设立的私募基金(以下简称"芯联投资基金")共同投资半导体产业配套精密零部件及自动化产线的研发、设计、生产及销售项目(以下简称"投资项目")。绍兴维新优科精密零部件有限公司(以下简称"维新优科"或"合资公司")作为投资项目实施主体。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次对外投资意向合作事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

二、交易对方

交易对方名称: 芯联私募基金管理(杭州)合伙企业(有限合伙)

注册地址:浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦 171-6室

统一社会信用代码: 91330109MACXLM812T

执行事务合伙人: 袁锋

资信状况良好,未被列为失信被执行人。

芯联基金拟作为私募基金管理人于浙江省绍兴市设立芯联投资基金并投资于合资公司,其中绍兴市各级政府单位拟在芯联投资基金出资占比约 30%,芯联集成电路制造股份有限公司在芯联投资基金出资占比不低于 65%(以芯联投资基金最终经备案的合伙人结构为准)。截至本公告披露日,芯联投资基金正在筹建中。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称:绍兴维新优科精密零部件有限公司
- 2、出资方式: 现金出资,资金来源为自有或自筹资金
- 3、标的公司基本情况

名称	绍兴维新优科精密零部件有限公司		
住所	浙江省绍兴市越城区皋埠街道漫池路13号2幢513室		
企业性质	有限责任公司(外国法人独资)		
注册地	浙江省绍兴市越城区皋埠街道漫池路13号2幢513室		
法定代表人	TAN YAN LAI(陈燕来)		
注册资本	200万美元		
经营范围	一般项目: 半导体分立器件制造; 电子元器件制造; 机械零件、零部件加工; 模具制造; 集成电路设计; 集成电路制造; 工业自动控制系统装置制造; 电机及其控制系统研发; 智能控制系统集成; 扩术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
股权结构	TANCON PRECISION ENGINEERING 持股100%		
是否为失信被执行人	否		
经营情况及主要财务	截止目前,维新优科尚未实际开展业务。		

4、投资方案具体情况

截至本公告披露日,公司控股股东 TANCON PRECISION ENGINEERING 持有维新优科 100%的股权。公司与控股股东 TANCON PRECISION

ENGINEERING 签署了股权转让协议,公司受让控股股东持有的维新优科 100% 股权。

芯联基金将作为私募基金管理人于浙江省绍兴市设立芯联投资基金并投资于合资公司,其中芯联集成在芯联投资基金出资占比不低于65%,绍兴市各级政府单位拟在芯联投资基金出资占比约为30%。该投资基金在中国证券投资基金业协会完成私募基金产品备案后完成对维新优科的增资。

维科精密拥有对合资公司的控制权,经维科精密增资和芯联投资基金增资入 股完成后,合资公司的股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本(万元)	出资比例
1	维科精密	9,000.00	90%
2	芯联投资基金(尚未设立)	1,000.00	10%
合计		10,000.00	100%

四、对外投资意向合作合同的主要内容

甲方:维科精密

乙方: 芯联基金

(一)投资合资公司

- 1、合资公司名称为: 维新优科
- 2、合资公司主营业务: 半导体产业配套精密零部件及自动化产线的研发、设计、生产及销售。

(二)投资总额与注册资本

- 1、芯联投资基金增资入股前,甲方拟受让 TANCON PRECISION ENGINEERING 所持有的合资公司全部股权,并变更合资公司注册资本为 9,000 万元人民币。
- 2、芯联投资基金增资入股完成后,合资公司的投资总额为49,000万元人民币,注册资本为10,000万元人民币,投资总额与注册资本的差额部分计入合资公司资本公积。合资双方以下列方式出资(最终金额及比例以工商登记为准):

- (1) 甲方持股比例为 90%: 以货币形式出资人民币 44,100 万元, 其中 9,000 万元计入合资公司注册资本;
- (2) 芯联投资基金持股比例为 10%: 以货币形式出资人民币 4,900 万元, 其中 1,000 万元计入合资公司注册资本。

(三)公司管理

合资公司按国家法规制定章程运营,合资公司的股东会由全体股东组成,为 合资公司的权力机构,合资公司不设董事会,设代表公司执行事务的董事一名, 由甲方提名,执行事务的董事担任合资公司法定代表人。合资公司的高级管理人 员(包括但不限于总经理、副总经理、财务负责人、各部门负责人等)由执行事 务的董事选聘。

(四) 合同生效

《合资经营合同》自双方签署之日起成立并自甲方履行内部有权机构审议通过之日起生效。双方进一步同意于芯联投资基金完成中国证券投资基金业协会私募基金产品备案后由芯联投资基金与甲方按照本合同的条款另行签署合资合同以取代《合资经营合同》。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

芯联集成系我国最大的车规级 IGBT 生产厂商之一,SiC MOSFET 出货量位居亚洲前列。公司与芯联集成参与出资设立的芯联投资基金共同投资的合资公司作为半导体零部件生产基地建设项目的实施主体,项目建成后将有利于提升公司半导体核心精密零部件的市场供给能力,增强公司在半导体领域的竞争力,构筑第二增长曲线,为公司长期发展提供有力保障。

2、存在的风险

截至本公告披露日,拟增资入股合资公司的芯联投资基金尚在筹建中,芯联 投资基金的设立、备案期限存在一定的不确定性,如因设立、备案期限与预期存 在差异,可能导致芯联投资基金增资入股时间未达预期。公司将持续跟进芯联投 资基金设立情况并依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意 投资风险。

在投资项目实施过程中,公司将严格按照预定计划推进项目落地,但若因宏观环境、经济政策变化、业主需求变化等因素导致实施进度、投资成本等方面出现不利变化,将可能导致投资项目实施周期延长或项目实施效果低于预期,进而对公司经营产生不利影响。

若未来市场环境、技术发展、相关政策等方面发生重大变化,导致实施过程中可能产生市场前景不明、技术保障不足等情况,使得投资项目无法按计划顺利实施,部分新产品最终未能通过客户验证或认证;或因实施过程中建设速度、运营成本、产品市场价格等与预测情况存在差异,导致实施效果与财务预测产生偏离,因此拟投资项目存在不能达到预期效益的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资意向合作项目的实施有利于扩大公司半导体核心零部件等高端 精密零部件的生产能力,将进一步优化公司高技术门槛产品体系、加快高端产品 布局,提升公司在半导体、集成电路以及汽车赛道的竞争力,为自身业绩增长提 供新引擎,推动公司进入高质量发展新阶段。

六、其他

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次对外投资意向合作事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次对外投资意向合作事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,同时为更好地推进本次对外投资事项,公司董事会同意授权公司管理层及其相关人员办理本次对外投资意向合作项目的有关事项,包括但不限于合资公司股权转让及增资的相关登记手续、芯联投资基金设立后的增资入股及另行签订合资经营合同、实缴出资、半导体零部件生产基地建设等事项。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议;
- 2、《合资经营合同》。

董事会 2025年10月23日